iPhone 18 получит революционный 2-нм чип A20 с упором на ИИ и игры благодаря новой технологии упаковки

Аналитик Мин-Чи Kyo сообщил, что iPhone 18 получит чип A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу и использующий новую технологию упаковки WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module).

Она позволит интегрировать процессор и память прямо на уровне пластины, без применения промежуточных подложек. Это улучшит тепловые характеристики, снизит энергопотребление и повысит скорость обмена данными.

WMCM использует метод MUF (Molding Underfill), который объединяет этапы заливки и формовки, сокращая количество материалов и операций, что повышает эффективность и выход годных чипов.

Такое решение, в сочетании с переходом на N2, даст заметный прирост производительности и автономности.

Основной упор Apple сделает на задачи, связанные с искусственным интеллектом и играми. Более близкое расположение памяти к процессору ускорит вычисления, особенно в ресурсоемких сценариях.

Запуск iPhone 18 ожидается во II половине 2026 года, а новые возможности чипа должны подготовить смартфон к эпохе массового внедрения ИИ.

Все права защищены